**MDD-01C SMT作业工艺要求**

1. 贴片元器件不可以有元件偏移，元件损伤，元件不贴板，元件贴反，元件飘浮，少锡，假焊，连锡。
2. 贴片过回流焊时要求温度范围不超过元器件标示的温度范围。
3. 注意接插件，电容位置不要装反，121PIN接插件安装时要与板子齐平。插件电容要插到底不可以有空隙即歪斜。插件元器件过波峰焊时不可以有元器件烫坏。
4. 元件及部件整齐，要求PCB板表面干净整洁。
5. 在加工过程中要求对电子元器件的各个工位，穿静电衣，佩戴静电手环等
6. SMT成品暂放要求，板与板之间有可靠保护或间隙，保证运输过程不会损伤元器件。
7. 贴片电感底部点胶处理，防止过回流焊是掉件。
8. 贴片时严格进行炉前炉后AOI检查。